Anmeldung

Die Einschreibung erfolgt über unser **ConfTool** auf **www.conftool.net/imaps-herbsttagung-2021**

Für den Nachweis der Mitgliedschaft bei IMAPS-Deutschland tragen Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer in das Registrierungsformular ein.

TEILNAHMEGEBÜHREN:
€ 140,- IMAPS-Mitglieder
€ 220,- Nichtmitglieder
€ 30,- Studierende

Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt gegen Rechnung.

In der Teilnahmegebühr sind die Tagungsunterlagen, der Pausenkaffee und die Teilnahme an der Abendveranstaltung im Augustiner enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Bitte melden Sie sich auf unserer Internetseite an!

www.imaps.de

WEITERE VERANSTALTUNGEN:
EMPC 2021, 13.–16. September 2021
EMPC 2021 Secretariat |Sweden Meetx AB
Tel. +(46) 31 708 86 90| empc2021@meetx.se |
https://www.empc2021.org

ESTC 2022, 13.–16. September 2022, Sibiu-Hermannstadt, Romania

Begleitende Ausstellung

Stand ca. 6 m². Mögliche Ausstattung (bitte mit Anmeldung übermitteln):

- **Tisch** (ca. 120 x 80 cm) und 2 Stühle
- **Pinnwand** (ca. 120 x 120 cm)
- **230 V-ANSCHLUSS**

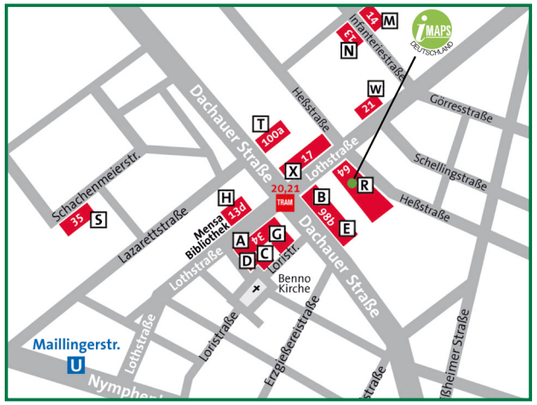
PREIS: € 790,-
Beinhaltet zusätzlich zum Stand auch die Teilnahme an der Konferenz und der Abendveranstaltung für 2 Personen.

ANMELDUNGEN ZUR AUSSTELLUNG
können Sie nur über unsere Internetseite vornehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!

Kontakt

ANREISE MIT DER BAHN U. ÖPNV
München Hbf bis Lothstrasse 64
Tram Linie 20/21 in Richtung
Moosach/Westfriedhof bis zur
Haltestelle Lothstrasse



Werbung auf der Internetseite

Wir bieten Ihnen an, auf www.imaps.de Ihre Werbeseiten zu präsentieren. Dazu benötigen wir von Ihnen die Dateiformate Acrobat (.pdf), CorelDraw (.cdr) oder alle Windows-Office-Formate (z. B. .doc, .ppt) per E-Mail.

PREIS: € 120,- für eine A4-Seite
(jede weitere Seite: € 60,-)

Im Preis ist auch ein Link auf Ihre Internetseite unter https://www.imaps.de für 1 Jahr enthalten.

INFORMATIONEN + RESERVIERUNG FÜR WERBUNG UND AUSSTELLUNG:

Ernst Eggelaar, MBA
Tel.: +49 8722/9620-0
E-Mail: info@imaps.de

IMAPS Deutschland

Deutsche IMAPS-Konferenz 2021

Herbstkonferenz
21.–22.10.2021

Hochschule München
Munich University of Applied Sciences
Lothstr. 64
D-80335 München

Foto umseitig ©Volker Mai / Fraunhofer IZM

09:00 – T1-B01: ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG
09:10 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*

09:10 – T1-B02: SINTERN & LÖTEN
10:25 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*

09:10 Bruchverhalten nickelpartikelverstärkter niedrig silberhaltiger SAC-Lotlegierungen unter Scherbelastung
Simon Keim, Ulrich Tetzlaff,
Technische Hochschule Ingolstadt

09:35 Neue Ergebnisse im Bereich des drucklosen und Niedrigdruck-Silbersinterns
Battist Rábay, *Nano-Join*

10:00 Die-Attach-Bonding mit gestapelten Kupfermetall-pigment-Flakes
Sri Krishna Bhogaraju[1], Maximilan Schmid[1], Elger Gordon[1], Martin Schneider-Ramelow[2], *[1]Institute of Innovative Mobility, Technische Hochschule Ingolstadt; [2]Fraunhofer IZM*

10:25 – T1-B05: VORSTELLUNG DER AUSSTELLER
10:45 Ort: Hörsaal
Chair: Dirk Schade, *XYZTEC*

10:45 – T1-B03: AUSSTELLUNG UND KAFFEEPAUSE
11:30 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH/IMAPS*

11:30 – T1-B04: LEISTUNGSELEKTRONIK
12:45 Ort: Hörsaal
Chair: Jens Müller, *TU Ilmenau*

11:30 Hochintegriertes SiC-Leistungsmodul in mehrlagiger Laminiertechnik
Jan Stolley, *Fachhochschule Kiel*

11:55 Optimierung eines Flüssigkeitskühlers für leistungs-elektronische Module von Motorsteuerungen
Bennet Lorbeer, *FuE-Zentrum FH Kiel GmbH*

12:20 Der Pump-Out-Effekt leistungselektronischer Baugruppen – Ursache und Wirkung
Stefan Söhl, *Fachhochschule Kiel*

12:45 – T1-B06: MITTAGSPAUSE UND FACHAUSSTELLUNG
13:45 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH/IMAPS*

13:45 – T1-B07: GEHÄUSUNGSTECHNOLOGIEN
15:00 Ort: Hörsaal
Chair: Artem Ivanov, *University of Applied Sciences Landshut*

13:45 Neue Gehäusetechnologien für optoelektronische Sensorsysteme
Marc Bochard, Manikandan Adaikkan
VIA electronic GmbH

14:10 ML-basierte Prozesssteuerung von Electronic Packaging Prozessen auf Basis des Compression Moldings
Corinna Niegisch[1], Isabel Zander[1], Sabine T. Haag[1], Martin Schneider-Ramelow[2], *[1]Robert Bosch GmbH; [2]TU Berlin*

14:35 Insitu cure and stress monitoring of an epoxy casting resin via dielectric and piezoresistive silicon-based stress sensors
Erick Franieck[1,2], Martin Fleischmann[2], Martin Schneider-Ramelow[1,3], *[1]Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, TU Berlin; [2]Automotive Electronics, Engineering Technology Polymer & Packaging, Robert Bosch GmbH; [3]Fraunhofer IZM*

15:00 – T1-B08: AUSSTELLUNG UND KAFFEEPAUSE
15:35 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH/IMAPS*

15:35 – T1-B09: ZUVERLÄSSIGKEIT, ANALYSE & TEST
16:50 Ort: Hörsaal
Chair: Stefan Härter, *Siemens AG / IMAPS*

15:35 Mechanisch beschleunigte Lebensdauertests an Aluminium-Dickdrahtbonds unter Berücksichtigung der Schädigungen des Heelbereiches
Florens Felke[1], Anne Groth[2], Martin Hempel[3], Bernhard Czerny[4], Torsten Döhler[1], Ute Geißler[1], *[1]TH Wildau; [2]TU Berlin; [3]Fraunhofer IZM; [4]TU Wien, Austria*

16:00 Thermomechanische Zuverlässigkeit großer MLCC Bauformen
Simon Schambeck, *BMW AG*

16:25 Untersuchung der durch Verbindungsprozesse generierten Spannung mit Raman-Spektroskopie (RS) und Akustische Mikroskopie (SAM)
Rokeya Mumtahana Mou[1], E Liu[2], Sri Krishna Bhogaraju[2], Fosca Conti[3], Gordon Elger[1], *[1]Applied Research Center „Connected Mobility and Infrastructure", Fraunhofer IVI [2]Institute of Innovative Mobility, Technische Hochschule Ingolstadt; [3]Department of Chemical Sciences, University of Padova, Italy*

17:00 – T1-B10: MITGLIEDERVERSAMMLUNG
18:00 Ort: Hörsaal
Chairs: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS,* Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH/IMAPS*

Ab 19:30 GEMEINSAMES ABENDESSEN IN DEN AUGUSTINER GASTSTÄTTEN
Neuhauser Str. 16, 1. OG, Grüner Saal

Freitag 22.10.2021

09:00 – T2-B01: KERAMIKSUBSTRATE
10:40 Ort: Hörsaal
Chair: Indira Käpplinger, *CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH*

09:00 „VE-CeraTrust" – Die Verhinderung von Angriffen auf Elektroniksysteme durch neuartige keramische Mehrlagensysteme
Peter Uhlig[1], Uwe Krieger[2], Franz Bechtold[2], Stefan Körner[3], Christian Lenz[3], *[1]IMST GmbH; [2]VIA electronic GmbH; [3]Fraunhofer IKTS*

09:25 Konstantan-Widerstandspasten mit niedrigem TKR
Pascal Sobek, Kathrin Reinhardt, Stefan Körner
Fraunhofer IKTS

09:50 Fundamental studies on crystallization behaviour and surface characteristics of LTCC substrate materials
Ali Hajian[1,2], Anna Artemenko[3], Alexandar Kromka[3], Franz Bechtold[2], Ulrich Schmid[1], *[1]Via Electronic GmbH; [2]Institute of Sensor and Actuator Systems, TU Wien, Austria; [3]Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Czech Republic*

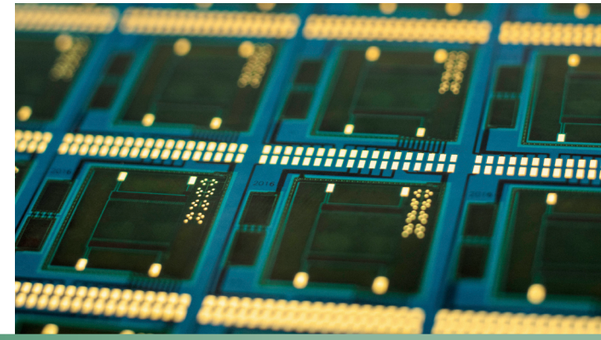
10:15 Fotostrukturierbare Pasten – Neuste Innovationen in der Fineline-Dickschichttechnik
Kathrin Reinhardt, Stefan Körner, Uwe Partsch
Fraunhofer IKTS

10:40 – T2-B02: AUSSTELLUNG UND KAFFEEPAUSE
11:30 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH/IMAPS*

11:30 – T2-B03: MATERIALIEN & PROZESSE
12:45 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*

11:30 Advanced Packaging Technology for VCSEL Arrays
Rainer Dohle[1], Gerold Henning[1], Maximilian Wallrodt[1], Christoph Gréus[2], Christian Neumeyr[2], *[1]Micro Systems Engineering GmbH; [2] VERTILAS GmbH*

11:55 Innovative Fügetechnologien zum Aufbau von feuchte- und temperaturstabilen Kraftsensor-systemen basierend auf piezoresistiven Silizium-Dehnmessstreifen
André Grün, *CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH*

12:20 Mikro-Kennzeichnung durch definierte, lateral verteilte Beschichtung unter Verwendung des Hundeknocheneffektes in der elektrolytischen Abscheidung von Metallschichten
Torsten Döhler[1], Andrea Böhme[1], Jens Neuman[2], Reinhard Bochem[2], Andreas Foitzik[1], *[1]TH Wildau; [2]Schiefer & Co. (GmbH & Co.)*

12:45 – T21-B04: SCHLUSSWORTE UND AUSBLICK
13:00 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*